

C205

寬帶等離子光學圖案晶圓檢測系統用以發現半導體晶片上的良率問題及缺陷

優勢：

C205可以對關鍵缺陷進行高敏度的檢測並加以分類，協助汽車晶片製造商：

- 通過特徵和優化新製程、設計節點和元件來加快研發並減少產品量產的周期時間
- 實施缺陷減少策略並滿足晶片的品質要求
- 採集準確和可操作的可靠性缺陷資料，用以減少晶片過度篩選
- 檢測小於設計規則的缺陷，避免其成為逃逸的潛在缺陷

技術：

- 可調節DUV、UV、可見光寬帶光源
- 可選光學孔徑
- 低噪音傳感器
- NanoPoint™技術
- 先進的缺陷檢測演算法
- 自動缺陷分類

應用：

- 為研發和量產提供系統性的缺陷偵測
- 製程窗口認證
- 為持續改進提供製程變化認證
- 需要高敏度關鍵製程的線上監控



市場：

用於汽車、物聯網、5G、消費電子、工業（軍事、航空、醫療）的較大設計節點元件的晶片製造

平台：

- 可定制的配置
- 可擴展
- 可升級

晶圓尺寸：

- 300mm
- 200mm

更多資料：www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-c205